

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2021-010

北京君正集成电路股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 468,977,393 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北京君正	股票代码	300223
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张敏	白洁	
办公地址	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼 A 座一至三层	
传真	010-56345001	010-56345001	
电话	010-56345005	010-56345005	
电子信箱	investors@ingenic.com	investors@ingenic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司为集成电路设计企业，自成立以来在嵌入式CPU、视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域持续投入，形成自主创新的核心技术；基于这些核心技术，公司推出了微处理器芯片和智能视频芯片两条产品线，并且围绕着这两条产品线，研发了相应的软硬件平台和解决方案，帮助客户快速把公司产品推向市场。公司的微处理器产品线主要应用

于生物识别、二维码识别、商业设备、智能家居、智能穿戴、教育电子及其他物联网相关领域，智能视频产品线主要应用于安防监控、智能门铃、人脸识别设备等领域。

报告期内，公司完成了对重大资产重组标的资产北京矽成的资产交割，北京矽成的主营业务为高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片和互联芯片的研发与销售，主要产品有SRAM、DRAM、FLASH、Analog及Connectivity等芯片产品，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。

公司专注于芯片的设计研发，产品采用Fabless模式运营生产，产品生产环节的晶圆生产、切割和芯片封装、测试均委托大型专业集成电路委托加工商进行。公司产品主要面向企业客户，客户采用公司的芯片后，需进行终端产品设计方案的研发。在销售模式上，公司采用直销和经销相结合的方式，其中对于重点客户，无论是通过直销或是经销的方式，公司均会直接对其进行技术支持和客户服务，协助客户解决产品开发过程中的技术问题。针对产品功能相近、市场量大的垂直市场，公司还会提供“Turnkey”的整体解决方案。

报告期内，因新冠疫情陆续在国内及全球爆发，公司各市场领域受到不同程度的影响，其中汽车电子、智能家居、智能穿戴、教育电子及其他部分物联网领域的销售收入出现下滑，而工业与医疗及部分消费市场则因疫情对需求的刺激而出现增长；随着国内疫情的缓解及需求的强劲反弹，下半年公司智能视频领域的芯片销售收入出现快速增长，汽车等行业市场的需求也出现反弹。综合上述因素，2020年公司总体营业收入保持了较好的增速。

报告期内集成电路设计行业的发展状况及对公司未来经营业绩的影响情况如下：

1、报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响

报告期内，受新冠疫情的影响，集成电路行业的总体发展情况为先抑后扬。上半年疫情的爆发导致集成电路设计行业多个细分领域出现较大幅度的下滑，尤其在汽车电子领域，同时，亦有部分领域的市场需求如医疗市场受到疫情刺激而出现增长；2020年下半年，国内集成电路行业因国内疫情的缓解而出现蓬勃发展的势头，国内市场保持了强劲的内需，海外市场也因多国政府对经济的拉动以及疫情对需求的压制逐渐释放，市场出现复苏。全年来看，全球集成电路行业总体仍保持了良好的发展趋势，根据Gartner报告，2020年全球芯片采购支出达4498亿美元，同比增长7.3%；据IC Insight发布的简报，2020年中国集成电路市场规模达到1434亿美元，同比增长约9%。市场的复苏和需求的反弹也推动了公司的市场销售。

随着全球集成电路市场需求的反弹及产业发展格局的变化，2020年下半年开始，从晶圆制造到封装测试的全产业链逐渐出现产能紧张，尤其在第四季度，集成电路行业多类芯片产品出现供求失衡，需求旺盛导致产能紧张不断加剧，预计该情形在2021年度仍将持续。因公司为委外生产，需求的不断增长和生产环节的产能紧张给公司部分产品的生产备货带来一定挑战。

为促进国家集成电路产业健康、稳定、持续的发展，国家和地方政府通过各项支持政策为集成电路产业的发展创造更为优良的环境。2020年3月，工业和信息化部等四部门决定废止《集成电路设计企业认定管理办法》，深化“放管服”改革部署，深入推进集成电路设计行业行政审批制度改革；科技部等五部门发布《加强“从0到1”基础研究工作方案》，为我国集成电路基础理论研究和核心技术突破带来助力。同时，各地方政府为集成电路设计行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，给企业创造了良好的经营环境，有力促进了本土集成电路设计行业的发展。国家和各级政府对集成电路设计产业的支持将为公司持续健康发展起到积极的促进作用。

与此同时，国际政治经济环境的变化使得国内集成电路行业，尤其是集成电路设计业成为贸易摩擦的焦点，给国内集成电路设计行业未来的发展带来一定的不确定性。

2、主流技术水平情况及市场需求变化情况及对公司影响

公司的集成电路产品根据产品功能和应用领域主要分为四类，存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯片。报告期内，公司芯片产品普遍面临更高性能、更高集成度和更低功耗等市场需求变化。为应对这一市场需求，公司不断加强技术研发，持续优化相关技术，不断提高新产品的技术水平。

公司存储芯片和模拟与互联芯片主要面向汽车电子、工业制造、医疗设备等行业市场，从技术和产品性能的要求上，车规级和工业级芯片对产品的可靠性、一致性、外部环境兼容性等方面的要求均比消费级芯片更为严格。在温度适应能力方面，消费级一般为0~70摄氏度、工业级一般为-40~85摄氏度、车规级一般为-40~125摄氏度；使用寿命方面，消费级一般为1-3年，工业级及车规级可能达到7-15年或以上；车规级及工业级芯片对振动、冲击、EMC电磁兼容性能等也有着更高要求。公司在易失性存储领域和非易失性存储领域均有多年丰富的行业经验，多年来专注于工业和汽车领域的应用，在产品温度适应性、品质控制方面有着严格的研发和测试流程，能够充分满足上述市场的要求。

公司微处理器和智能视频芯片主要面向智能物联网和智能安防类市场，在这些市场中，AI已得到越来越多的普及，从应用上，云端的算法和部分应用逐渐在向端级迁移，从而在面向终端产品的芯片的性能方面，对其AI处理能力的要求不断提高。同时，信息处理需求的增加要求芯片运算能力不断提高。在智能视频领域，对芯片高清性能的要求也不断提高。随着公司XBurst2 CPU内核的成熟，公司新一代芯片在计算能力方面得到很大提高，同时，公司近几年来在AI算力和算法技术方面的积累，很好地满足了市场对这两类芯片在AI性能方面的需求。

3、所在行业的竞争情况和公司综合优劣势

公司产品主要面向两大类市场。第一类是智能硬件、智能安防等新兴市场，这个市场因空间广阔、发展迅速而获得了传统手机芯片厂商、无线芯片厂商、多媒体芯片厂商、MCU厂商的参与，竞争非常激烈；第二类是汽车电子、工业制造、医疗设备、通讯设备等行业市场，这个市场面临美光、海力士、赛普拉斯、华邦等国际半导体企业的竞争，竞争也比较激烈。在激烈的市场竞争中，自主可控的核心技术和产品的成本控制一直是公司重要的竞争优势之一。

公司通过多年的研发投入，在嵌入式CPU技术、视频编解码技术、影像信号处理技术、神经网络处理器技术、AI算法技术、高性能存储器技术、模拟技术、互联技术、车规级芯片设计技术等形成了多项核心技术，且技术领先、自主可控。公司在关键核心技术上的自主设计大大降低了芯片在设计、生产和销售等阶段的相关技术授权费用，从而有利于公司的成本控制；同时，关键技术的自主研发还可以在芯片设计时针对特定应用市场进行定制设计而避免不必要的冗余，从而进一步节

省了成本；此外，在研发中，公司紧密跟踪先进工艺制程的发展情况，选择适合产品需求的最经济合理的工艺节点，这也是公司对产品成本控制的重要手段之一。公司自主创新的核心技术和产品突出的性价比优势，使公司的市场销售在近几年来一直保持了良好的发展势头。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,169,801,108.34	339,351,160.33	539.40%	259,670,111.20
归属于上市公司股东的净利润	73,200,491.02	58,659,727.20	24.79%	13,515,446.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,491,354.09	-2,516,680.36	914.22%	-20,762,201.76
经营活动产生的现金流量净额	312,156,606.48	15,185,933.81	1,955.56%	36,370,741.66
基本每股收益（元/股）	0.2072	0.2914	-28.89%	0.0674
稀释每股收益（元/股）	0.2072	0.2902	-28.60%	0.0576
加权平均净资产收益率	1.48%	4.95%	-3.47%	1.19%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	8,968,292,062.09	1,309,468,574.98	584.88%	1,197,980,221.27
归属于上市公司股东的净资产	8,194,742,923.18	1,235,363,809.31	563.35%	1,141,926,913.09

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,990,519.32	297,745,932.69	873,438,274.79	941,626,381.54
归属于上市公司股东的净利润	12,483,190.85	-1,011,979.19	10,949,698.31	50,779,581.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,556.14	-11,043,080.07	1,685,130.20	29,933,860.10
经营活动产生的现金流量净额	-43,113,679.38	47,672,503.20	128,688,483.71	178,909,298.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,285	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,105	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数	质押或冻结情况		

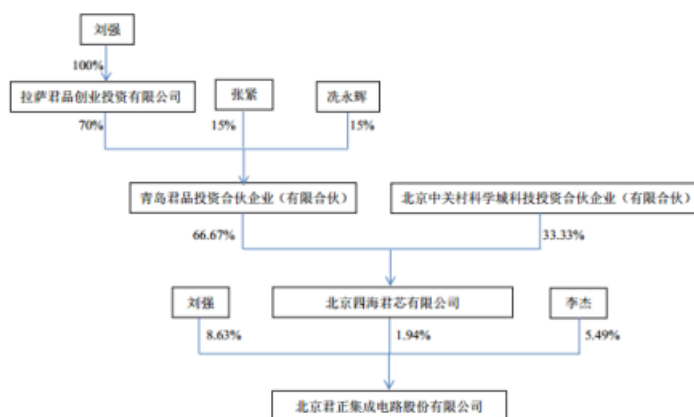
				量	股份状态	数量
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.91%	60,556,704	60,556,704		
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.91%	60,544,310	60,544,310		
上海双创投资管理有限公司—上海集岑企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	11.48%	53,835,926	53,835,926		
刘强	境内自然人	8.63%	40,475,544	30,356,658	质押	13,295,800
李杰	境内自然人	5.49%	25,728,023	22,173,141	质押	9,320,000
北京华创芯原科技有限公司	境内非国有法人	4.92%	23,054,968	23,054,968	质押	4,530,145
上海瑾矽集成电路合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	14,795,533	14,795,533		
青岛民和志威投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.68%	12,577,174	12,577,174		
上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.59%	12,133,570	12,133,570		
洗永辉	境内自然人	2.33%	10,908,659	8,181,494	质押	2,849,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东刘强先生和李杰先生为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司完成了对北京矽成的收购事项，北京矽成作为公司全资子公司，自2020年6月起纳入公司合并报表编制范围。本次并购完成后，公司的业务体量、市场领域与资产规模等均得到大幅提高，极大地增强了公司的核心竞争力和抗风险能力。公司将充分发挥北京矽成境内外资源与渠道及公司在国内的本地化优势，推动公司总体业务在全球范围内的协同发展。

在新冠疫情的影响下，公司多个领域的市场销售受到不同程度的影响，公司积极组织复工复产，努力挖掘重点市场潜力，寻找新的市场机会，降低疫情对公司经营的不利影响。2020年下半年，公司及时把握市场复苏的机会，加大产品的市场推广力度，公司主要产品线销售收入均呈现较好的增长趋势，其中北京矽成在汽车电子市场遭遇较大冲击的情况下，及时把握医疗、工业及高端消费市场的需求，全年营业收入仍实现了同比增长。

与此同时，公司因本次收购产生了较大的存货、固定资产和无形资产等资产评估增值，其折旧与摊销致使营业成本和经营费用同比大幅增长，一定程度上抵消了公司经营净利润的增幅，该部分对公司报告期损益的影响金额合计为12,131.04万元。

报告期内，公司实现营业收入216,980.11万元，同比增长539.40%；实现净利润7,296.16万元，同比增长24.38%，其中归属于母公司股东的净利润7,320.05万元，同比增长24.79%。具体来说，报告期内公司主要经营情况如下：

1、完成重大资产重组事项，公司发展迈向新台阶

公司于2019年12月31日收到中国证监会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938号），核准公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司通过发行股份及支付现金的方式向屹唐投资、武岳峰集电、华创芯原等13名交易对方购买其持有的北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额，合计交易作价72亿元，同时拟向包括北京四海君芯有限公司在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金15亿元。

公司分别于2020年4月和2020年5月完成了北京矽成59.99%股权和上海承裕100%财产份额过户至公司及合肥君正的工商变更登记手续。2020年5月，公司完成了本次购买资产对应新增股份的发行事项，新增股份248,650,730股于2020年5月22日上市。2020年9月，公司完成本次重大资产重组募集配套资金的股份发行，新增股份18,181,818股于2020年9月11日上市。

公司完成本次重大资产重组事项后，公司资产规模、业务体量、应用领域和产品类别等均得到大幅提高或扩展。公司业务从微处理器和智能视频芯片两条业务线，扩展至涵盖SRAM、DRAM、NOR Flash和NAND Flash等主要存储器类别的存储芯片业务线和包含LED驱动芯片、触控传感芯片、LIN、CAN、G.vn等在内的模拟与互联芯片业务线；市场从以物联网、消费类IPC市场等消费类市场为主，扩展至汽车、工业、医疗、通讯、高端消费及大众消费类市场等多个市场领域，客户亦包含了众多全球一线品牌厂商。本次并购是公司发展中的重要里程碑，自此，公司拥有三大业务品牌：Ingenic、ISSI和Lumissil，分别包括微处理器芯片和智能视频芯片、存储芯片、模拟与互联芯片的业务，公司拥有了面向多类重要芯片领域的核心技术，并拥有全球化的客户资源、渠道资源、市场资源和全球化的人才资源，使公司能够站在更高的平台谋求更大的发展空间。

2、进行了并购后公司治理和管理方面的整合工作，不断推动总体经营水平的提高

报告期内，公司进行了并购后公司治理层面、管理层面和日常经营层面等多个维度的整合，公司对北京矽成和公司层面的董事会先后进行了改组，各经营部门完成了相应的工作对接，公司将北京矽成纳入子公司管理范畴。公司通过北京矽成的股东会、董事会及日常管理等多个维度，对其进行全方位整合与融合，北京矽成经营主体ISSI原为美国上市公司，其管理层成员为非常优秀的职业经理人，且长期以来保持稳定，北京矽成的管理风格与公司既各有特点，也存在很多相似之处，双方管理层高度认可对方，公司各方面的整合工作进展顺利。

公司并购完成后，资产规模和业务规模均大幅提高，给公司的管理水平带来更高的要求，公司不断调整和优化经营管理体制，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，注重人才队伍培养，加强管理团队对先进管理经验的学习，进一步提高公司整体经营管理水平。

此外，为进一步促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于2016年实施了股票期权激励计划，将部分高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员纳入本次激励范围。报告期内，公司股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件可以行权，行权期限为2019年4月13日至2020年4月12日。报告期内，公司股票期权激励计划实际行权数量为52,752股，公司完成了本次股票期权激励计划。

3、加强公司并购后的技术与业务整合，推动公司各业务协同发展

从业务的协同方面，公司与北京矽成均主要从事集成电路芯片及其衍生产品的研发与销售，其中北京矽成拥有存储芯片、模拟与互联芯片等多种产品，其产品具有高品质、高稳定性的特点，北京矽成拥有全球化的市场资源，客户多为国际一线品牌客户；公司微处理器芯片产品和智能视频芯片产品具有独特的低功耗、高智能化等特点，以及极具竞争力的性价比优势，公司在国内市场耕耘多年，熟知国内市场特点。因此，公司本次重组为对同行业优质企业的整合收购，在技术研发、产品类型、客户与市场、供应链资源以及质量管控等多方面都具有较强的协同。并购后，可将公司自身在处理器和AI领域的优势

与北京矽成在存储器和模拟芯片领域的强大竞争力相结合，形成“计算+存储+模拟”的技术和产品格局，布局和拓展公司各产品线在汽车电子、工业控制和物联网等领域的应用，利用北京矽成多年积累的优质国际客户资源和公司在国内市场多年的行业经验，形成“海外+国内”并进的市场布局，拓展市场规模，强化公司的行业竞争力，形成良好的规模效应及互补效应。

报告期内，公司原有业务部门与北京矽成的相应部门进行了密切的技术沟通和市场交流，双方深入了解对方的技术优势和产品特点，寻求技术与市场整合的切入点，推动内部IP技术共享，向客户提供多芯片整合方案，积极寻找市场协同发展机会，并在供应链管理上进行优势互补。公司微处理器和智能视频业务的相关人员展开了对汽车领域中技术和产品要求及流程控制等方面的学习，为后续进入汽车市场积极准备。同时，近几年来国产替代给国内芯片公司带来了非常好的发展机遇，公司在国内市场耕耘多年，熟悉国内市场环境，针对消费类市场的机会，尤其在物联网快速发展和国内市场国产替代的机会下，公司于2020年下半年设立了控股公司上海芯楷集成电路有限责任公司，以开展面向大众消费市场的非易失性存储器产品研发与市场推广等业务。

随着业务的不断融合，公司将从技术、产品、市场等各个方面进行全局规划，实现各业务线的优势互补，推动旗下各项业务在公司整体资源下的协同发展，以实现北京君正原有业务迈向国际市场和新增的业务在国内市场纵深发展的目标。

4、积极应对疫情危机，抓住市场复苏机会，保持市场销售的持续健康发展

2020年一季度新冠疫情爆发后，国内部分企业停工待产导致市场受到较大冲击，公司微处理器业务和智能视频业务均受到不同程度的影响，在此情境下，公司积极组织复工复产，加强客户支持和市场推广工作，积极把握疫情下的市场需求，自二季度开始两大业务均开始逐渐复苏，并逐季度保持了增长趋势。北京矽成方面，近几年来其一半以上的业务来自汽车领域，2020年上半年，北京矽成境内外业务先后因疫情影响受到冲击，尤其在汽车领域，疫情给全球汽车行业带来了较大的不利影响，北京矽成在汽车领域的销售也出现了较大下滑。北京矽成积极应对疫情冲击，及时抓住工业、医疗、高端消费市场的机会，弥补了在汽车这一主要领域的销售下滑，总体销售收入自二季度开始逐渐恢复增长。

2020年下半年开始，在各国政府纷纷出台经济刺激政策的情况下，市场需求开始出现复苏，公司积极把握行业复苏机会，加大市场推广和客户拓展力度，并提早对供应链进行规划，公司下半年各主要业务线均保持了良好的增长。

从各应用领域来看，微处理器芯片所面向的各类智能硬件市场全年受疫情影响较大，公司加强对二维码、生物识别、智能家居等领域的客户维护，积极配合客户的产品开发工作，充分保障客户的采购需求，同时，在智能锁、打印机、工业控制、教育电子等市场积极拓展。2020年下半年，基于Xburst2 CPU核的芯片产品推出后，公司迅速展开新产品推广，密切配合客户的方案研发，第一个基于该芯片的产品外研通点读笔于2021年初上市销售。尽管微处理器业务同比出现下降，但从全年来看，该产品线总体市场销售各季度呈现了良好的增长趋势。

在智能视频领域，随着公司产品线的不断丰富，公司客户群体不断增加，公司在行业的知名度逐渐提高。尽管有疫情的影响，全年仍实现了快速发展。依托公司产品的低功耗、高智能化优势，公司在消费类IPC产品市场不断取得新的突破，其中在运营商领域获得良好的客户认可，逐渐立足；在电池类IPC领域，多个重要客户的关键性产品实现落地，新客户不断导入，市场影响力逐渐加大。在泛视频领域，公司抓住疫情下的新机会，成为webcam的主力供应商之一，带动了公司市场销售的增长。2020年下半年，随着客户需求的不断增长，视频产品线出现供应紧张，公司及时进行供应链的调整，加大产品生产投入，尽最大努力满足客户需求。

在汽车领域，由于新冠疫情对全球汽车市场带来较大的不利影响，一方面抑制了汽车市场的消费需求，另一方面疫情严重期间，客户的停工停产也导致了市场销售受阻，2020年上半年汽车领域的销售出现较大下滑。公司积极应对疫情下的各种问题，密切配合客户需求，在疫情下仍保障了供应的及时和稳定。2020年下半年开始，汽车领域的销售开始复苏，公司在汽车领域的收入也恢复了良好的增长趋势，预计汽车领域的销售将于2021年保持增长。近几年来，随着新能源车、智能车的快速发展，汽车市场对电子元器件的需求也持续增长，汽车市场一直是公司重要布局的领域，公司不断丰富产品线，积极把握市场需求，在新产品研发方面与客户密切配合，汽车市场将成为公司长期稳健发展的重要基础。

在工业和医疗领域，疫情的发展导致了医疗设备的需求增长，公司在这一领域的客户主要为国际一线品牌客户，行业需求带动了公司的市场销售，同时，公司产品的高稳定性、高可靠性也促进了公司在这一领域的推广，从而全年实现了较好的增长。此外，在通信和消费类市场，疫情对各类产品的需求情况有不同影响，受益于公司产品的高品质，公司在高端消费市场如硬盘市场获得较好的市场机会，在这些领域中总体收入实现了同比增长。

围绕公司在汽车、工业与医疗等领域的市场基础和品牌优势，北京矽成多年来一直坚持多样化产品的发展战略，报告期内，公司多样化产品战略获得成效，在疫情的不利因素下，公司Flash和Analog产品的销售收入仍实现了较好的增速，从而保障了总体市场销售的增长。

5、加强核心技术的研发，推动新产品不断落地

公司拥有存储芯片、模拟与互联芯片、微处理器芯片和智能视频芯片等多个业务产品线，在CPU、AI、多媒体、SRAM、DRAM、Flash、Analog、MCU、Connectivity等多个领域中拥有自主可控的核心技术。报告期内，公司持续进行核心技术的研发。

报告期内，公司进行了XBurst2 CPU内核的优化工作，并继续推进RISC-V CPU内核的研发，在视频编解码、影像信号处理、神经网络处理器、AI算法等领域继续推进相关技术的研发与创新，提高技术领先性，增强核心技术的积累。经过多年的积累，公司在AI领域，包括AI处理器引擎和算法方面的技术不断成熟，算法技术种类不断丰富，公司各类算法可应用于多个场景，满足客户在智能时代越来越多的市场需求。根据市场需求趋势，公司在存储业务方面不断积累高容量、高性能和低功耗方面的技术开发能力，并继续致力于产品质量的不断提升和成本的持续优化；在模拟与互联业务方面，公司在高亮度、高电流和灯效LED方面，以及先进的汽车内部连接技术方面持续进行研发投入，引领行业的需求趋势；同时，鉴于公司拥有多类车用芯片产品，公司亦进行了整合LED驱动芯片、MCU和LIN/CAN等芯片的系统解决方案的研发。根据市场需求和公司业务规划，公司积极推进各产品线的新产品开发，同时，持续加大研发投入，加强基础技术的研发和技术创新能力。

公司存储芯片分为SRAM、DRAM和Flash三大类别。公司SRAM产品品类丰富，从传统的Synch SRAM、Asynch SRAM产品到行业前沿的高速QDR SRAM产品均拥有自主研发的知识产权；报告期内，公司进行了不同容量的SPI/QPI/Hyper/Octal/

Serial SRAM产品的工程验证及送样。公司DRAM产品开发主要针对具有较高技术壁垒的专业级应用领域，可向客户提供不同容量、不同界面和不同功耗规格的产品，能够满足工业、医疗、主干通讯和车规等级产品的要求，具备在极端环境下稳定工作、节能降耗等特点；报告期内，公司进行了不同容量的DDR4、LPDDR4、LPDDR2、LPDDR等产品的研发、工程验证及送样，部分产品带有ECC功能。公司Flash产品线包括了目前全球主流的NOR Flash存储芯片和NAND Flash存储芯片，其中NOR Flash存储芯片具有串口型和并口型两种设计结构，NAND Flash存储芯片主攻大容量规格，报告期内，公司继续进行面向汽车领域的高容量NOR Flash及最新界面Octal Flash产品研发和送样，并同时进行了新制程NAND Flash的产品开发，公司不断优化Flash产品的封装测试流程及参数，持续优化产品成本。公司控股子公司上海芯楷面向消费类市场的NOR Flash也展开研发工作。

公司模拟与互联产品线包括LED驱动芯片、触控传感芯片、DC/DC芯片、车用微处理器芯片、LIN、CAN、G.vn等网络传输芯片，主要面向汽车、工业、医疗及高端消费类市场。报告期内，公司继续开发面向汽车应用的LIN、CAN、G.vn接口的网络传输产品、应用于汽车和高端消费类市场的灯效FxlED驱动芯片、各种LED车灯驱动芯片、汽车DC/DC调节芯片、触控传感芯片等，部分产品进行了样品生产和风险试产，部分产品获得客户验证，正在逐步进行量产，车用微处理器新产品也在批量生产中。

公司微处理器芯片新产品于2020年下半年完成量产工作并推向市场，该芯片采用了公司最新的XBurst2 CPU核，主要面向消费电子领域的中高端应用，亦可用于工业控制等行业市场。

在智能视频领域，公司IPC芯片新产品于2020年下半年完成投产工作并及时展开了方案研发，该芯片可满足智能视频领域不断提高的对AI处理能力的需求，并具有良好的性价比优势。为不断完善公司在视频监控领域的产品线，公司展开了视频监控领域后端芯片的产品研发，该芯片预计将于2021年投产。

6、合肥君正研发楼建设

由于新冠疫情的影响，合肥君正二期研发楼相关工作有所延迟，报告期内，公司完成了开工建设前的市政审批工作，确定了施工、监理等相关合作单位，并开始了大厦的主体建设施工。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
微处理器芯片	123,727,517.83	55,283,147.24	55.32%	-15.72%	-17.68%	1.06%
智能视频芯片	291,316,337.75	217,753,925.99	25.25%	63.16%	59.67%	1.63%
存储芯片	1,525,458,558.07	1,209,240,234.98	20.73%	0.00%	0.00%	0.00%
模拟与互联芯片	187,477,013.90	95,932,791.36	48.83%	0.00%	0.00%	0.00%
技术服务	31,356,848.46	2,211,970.05	92.95%	998.13%	0.00%	-7.05%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

公司于2020年5月完成对北京矽成的资产交割，北京矽成财务报表自2020年6月起纳入公司合并报表范围，导致报告期内营业收入、营业成本较前一报告期发生重大变化。

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知，本公司在编制2020年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第十二次会议批准。	说明1

说明1：根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。与原收入准则相比，执行新收入准则对本公司2020年初财务报表相关项目余额的影响如下：

受影响的资产负债表科目 对2020年1月1日余额的影响金额

受影响的资产负债表科目	对2020年1月1日余额的影响金额	
	合并资产负债表	母公司资产负债表
合同负债	4,413,520.92	3,470,070.25
预收款项	- 4,949,432.27	- 3,891,850.39
其他流动负债	535,911.35	421,780.14

除上述事项外，本公司本年内无其他重大会计政策、会计估计相关变更事项。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

参见“财务报告”中的“八、合并范围的变更”相关内容。

北京君正集成电路股份有限公司

法定代表人：刘强 _____

二〇二一年三月二十六日